

Foxconn, Radiall et Thales ont officialisé, ce lundi 1^{er} juin 2026, la création de leur coentreprise Tessalia Technology SAS, dédiée à l'assemblage et au test de composants semi-conducteurs avancés. La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue au Barp, en Gironde, en marge du sommet Choose France 2026.

La création de cette structure avait été annoncée lors du sommet *Choose France 2025* par le président Emmanuel Macron, qui avait alors évoqué l'ouverture de discussions préliminaires entre les trois groupes. En l'espace d'un an, le projet a abouti à la constitution d'une entité juridique et au lancement effectif des travaux.

Le site retenu, Le Barp, se situe à proximité de Bordeaux, dans un territoire qui accueille déjà plusieurs infrastructures de recherche et de production dans le domaine des technologies avancées, notamment la « *Route des Lasers* ». La région Nouvelle-Aquitaine revendique quelque 20 000 emplois dans le secteur de l'électronique.

La société sera spécialisée dans l'OSAT (*Outsourced Semiconductor Assembly and Testing*), soit l'assemblage et le test externalisés de semi-conducteurs. Plus précisément, elle fabriquera des composants de type *System in Package* (SiP) — une technologie qui consiste à intégrer plusieurs fonctions électroniques dans un seul boîtier compact. Ces composants sont destinés aux secteurs de l'aérospatial, des télécommunications, de l'automobile et du médical.

Tessalia utilisera une technologie d'encapsulation à haute densité visant à simplifier les circuits imprimés et à réduire la taille et le poids des composants. Le démarrage de la production est prévu pour fin 2029. L'objectif est d'atteindre 50 millions de composants SiP produits annuellement d'ici 2033.

L'investissement total pourrait excéder 250 millions d'euros à l'horizon 2033, selon le communiqué. Les trois fondateurs indiquent vouloir ouvrir le capital à d'autres acteurs industriels. À pleine capacité, Tessalia devrait employer 800 personnes.

Foxconn apportera sa technologie sous forme de licence. Radiall, fabricant français de solutions d'interconnexion fondé en 1952, et Thales, groupe de technologies de défense et de sécurité, complètent le tour de table. La gouvernance exacte de la coentreprise (répartition du capital, organes dirigeants) n'est pas précisée dans le communiqué.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'*EU Chips Act*, le règlement européen adopté pour soutenir le développement de l'industrie des semi-conducteurs sur le continent. Il répond à une préoccupation croissante des industriels et des gouvernements européens face à la dépendance aux fournisseurs asiatiques, accentuée par les tensions géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales survenues ces dernières années.

Le nom retenu pour la coentreprise, Tessalia, est une référence à la tesselle, petite pièce constituant une mosaïque ; une métaphore choisie par les fondateurs pour illustrer l'assemblage de composants au sein d'un système intégré.